

CI / Logo



슬로건(200자이내)

We Bring Intelligence Everywhere

모빌린트는 모든 사물이 인공지능을 갖는 편리하고 안전한 세상을 만듭니다.

기업 개요

설립일	2019. 04. 17
대표자명	신동주
고용	44명
업종/업태	서비스업/전기 및 전자공학 연구개발업
주요기술 분야	엣지용 AI 반도체 개발 및 판매
메인 아이템	고성능 저전력 NPU, AI SoC

주요 구성원(3인)

신동주	대표이사 / CEO & CTO 경력 KAIST 전기 및 전자공학과 박사 세계 최초 CNN, RNN 동시처리 가능한 Edge ASIC NPU 개발
박종준	이사 / Chief Compiler Engineer 경력 KAIST 수리과학과 박사 前 삼성전자 데이터분석연구실
이정승	이사 / Chief Algorithm Engineer 경력 KAIST 수리과학과 학사 前 삼성증권 구조화금융팀

주소

본사 서울특별시 강남구 선릉로93길 35, 나라키움 역삼 B 빌딩 3층

해외 지사

기업 소개 및 비전(200자이내)

모빌린트는 세계 최고 수준의 엣지 AI 반도체를 개발, 공급하는 팹리스 기업이다. 모빌린트 제품은 소비전력, 공간, 비용이 제한된 조건에서 높은 성능을 낼 수 있어 고성능 엣지 AI 기능 구현에 적합하다. 또한, HW 최적 SDK를 제공해 높은 사용자 편의성을 갖췄으며, 최신 AI 모델 포함 200종 이상의 네트워크 모델을 지원한다.

매출 - 비공개

국내(원/천원)		해외(달러/\$)	
2022	2023	2022	2023

주요 거래처(4개 제한) - 비공개

투자유치 이력(최근 5개 제한)

일자	투자자	투자단계	금액(원/천원)
2023.12		Series B	20,800,000천원
2021.07		Series A	9,000,000천원

Business Strategy

모빌린트는 고성능 저전력 엣지 AI 반도체를 설계, 공급하는 팹리스 기업이다. 주로 스마트팩토리, 스마트시티, 자율주행로봇, 드론, AI CCTV 분야의 고성능 엣지 AI 어플리케이션에 활용된다. 우월한 기술력과 고객 친화 사후 지원을 강점으로 국내 시장의 고객을 확보하고, 동시에 미국, 유럽, 중동 등 해외시장에도 사업을 전개할 계획이다.

2022년 12월 첫 ASIC 시제품을 개발한 이후 30여 고객사와의 PoC를 통해 검증을 마치고 2024년 양산 단계에 돌입했다. PoC를 통해 고객을 최대한 확보한 이후 양산 시기에 맞춰 판매 채널 확보, 각종 인증 획득, 해외 법인 설립 등을 수행하고 2025년 본격적인 매출 성장을 계획하고 있다.

Images



CES, MWC, GITEX 등 다양한 전시회 참가를 통한 홍보



엣지 AI 관련 파트너와 MOU 체결

지식재산권 & 수상내역

2024. 05.	AI 반도체 관련 국내외 특허 25건 이상 출원, 15건 이상 등록	2023. 08.	산업통상자원부 글로벌스타팹리스 30 선정
		2023. 04.	2023 ImpaCT-ech 과학기술정보통신부 장관상
		2020. 12.	3대 신산업 우수기업 선정 및 중소벤처기업부 장관 표창

## Technology

### 세계 최고 수준의 엣지 AI 반도체

모빌린트 NPU는 고성능 딥러닝 가속기 'ARIES', 저전력 AI SoC 'REGULUS' 2종이 출시되어 있다. ARIES는 PCIe Card 'MLA100'과 고성능 AP가 탑재된 AI Box 'MLX-A1' 2가지 형태로 공급된다. 두 제품은 엣지 AI 반도체 중 세계 최고 수준인 64 TOPS의 AI 성능이 특징이며, 전력효율과 가격 효율도 기존 반도체를 상회한다.

REGULUS는 CPU, NPU, ISP, 코덱 등을 내장한 저전력 고효율 AI SoC이다. 5W 이하의 매우 적은 전력을 소비하며 8 TOPS의 충분한 성능을 낼 수 있어 온디바이스 AI 기기들에 적합하다.

모든 제품은 자체 개발된 NPU 최적 SDK 'qb'와 함께 제공된다. 기존 개발환경과 유사한 환경을 제공하는 사용자 친화 인터페이스로 운영 비용을 최소화하고 쉽게 개발할 수 있으며, 하드웨어 자원 사용률을 극대화할 수 있어 더 높은 AI 성능을 낼 수 있다.

### 시제품 검증 완료 및 양산, 상용화 돌입

NPU HW 아키텍처, NPU ASIC 시제품 검증 완료 후 양산 단계 진행 중

#### 1. NPU HW 아키텍처

- FPGA를 통해 검증 완료, 글로벌 AI 반도체 벤치마크 MLPerf에서 국내 1위 달성 및 MLCommons 창립 멤버 등재

#### 2. 고성능 AI 가속기 'ARIES'

- 수십 건의 PoC를 통해 고객사 검증 완료, Transformer 모델 지원 업데이트와 함께 양산 제품 출시 예정

#### 3. 저전력 고효율 AI SoC 'REGULUS'

- ASIC 시제품 생산 완료 및 검증 수행 중



### AI 기기 성능 향상 및 비용 절감을 위한 최고의 선택

#### 1. 기존 반도체를 압도하는 전력 효율, 가격 효율

- 고객사의 엣지 AI 기기 제작 비용, 유지비용을 크게 절감하고 기기의 최대 작동시간을 증가시켜 효율성 향상  
- 높은 유효성능을 이용해 고성능 AI 모델 사용을 통한 정확도 개선, Input 채널 증가 등을 통해 AI 기기 개선 가능

#### 2. 높은 수준의 SW 완성도와 기술지원

- 사용자 친화 인터페이스를 갖추고 최신 모델 포함 200종 이상의 AI 모델 지원하는 범용성을 제공하는 SDK 'qb' 제공  
- 국내 최고 수준의 AI, SW 개발진을 보유해 고객사 눈높이에서 문제해결 가능

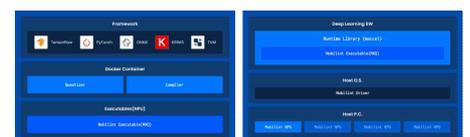
## Images



NPU PCIe 카드 'MLA100'



독립형 NPU AI Box 'MLX-A1'



NPU 최적 사용자 친화 SDK 'qb'